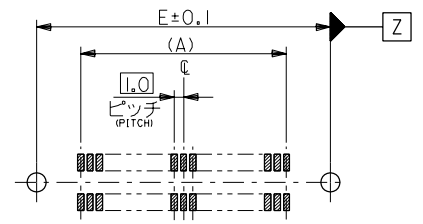


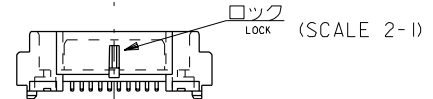
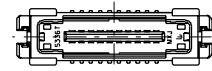
推奨基板寸法 (20, 100, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,100,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)



推奨基板寸法 (34, 66極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,66 CKTS.)
(SCALE 2-1)

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP, 白色, UL 94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL 94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ0.25 μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部: 半田メッキ1.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: IN-LEAD 1.0 μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μmMIN.
- 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm MIN.
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ0.02MAX、
下へ0.13MAXとする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.02MAX. UPWARD AND 0.13MAX. DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE.
- ロックは、20, 34極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20 AND 34 CKTS.



- 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後のENG. NO. は
53395-***9とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO. 53395-***9
- 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B. BOARD.

78.4	80.8	72.4	76.02	69	53395-1400	140
58.4	60.8	52.4	56.02	49	53395-1000	100
41.4	43.8	35.4	39.02	32	53395-0660	66
25.4	27.8	19.4	23.02	16	53395-0340	34
18.4	20.8	12.4	16.02	9	53395-0200	20
E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	CHK'D BY
APP'D BY	DATE

角度 ANGLE	±3°	C	変更 (140838)	S.A.	J.M.	94/11/08
30以上 OVER	+0.3	B	変更 (130355)	J.M.	Y.I.	93/7/18
10以上 30未満 UNDER	+0.25	A	変更 (130299)	J.M.	Y.I.	93/6/11
10未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 RELEASED (120452)	J.M.	M.S.	92/10/27

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 I.O B-T0-B S/T PLUG HS'G ASS'Y	
DWG. NO. SD-53395-***0	REV C

